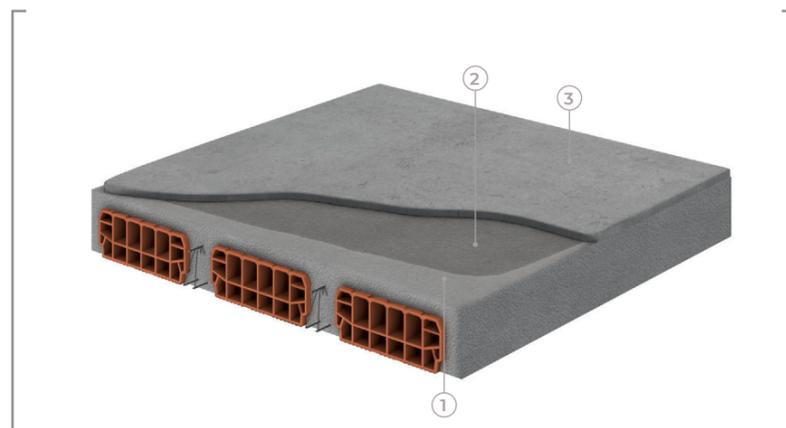


## RINFORZO DI SOLAI CON CAPPА COLLABORANTE A BASSO SPESSORE RINFORZO DI SOLAI PIANI CON CAPPА COLLABORANTE A BASSO SPESSORE MEDIANTE HPC SYSTEM: PLANITOP HPC FLOOR



- ←
- 1 | SOLAIO ESISTENTE IN LATERO CEMENTO
  - 2 | PRIMER 3296
  - 3 | PLANITOP HPC FLOOR
  - 4 | COLLEGAMENTO PERIMETRALE FISSATO CON MAPEFIX EP 100

### PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO

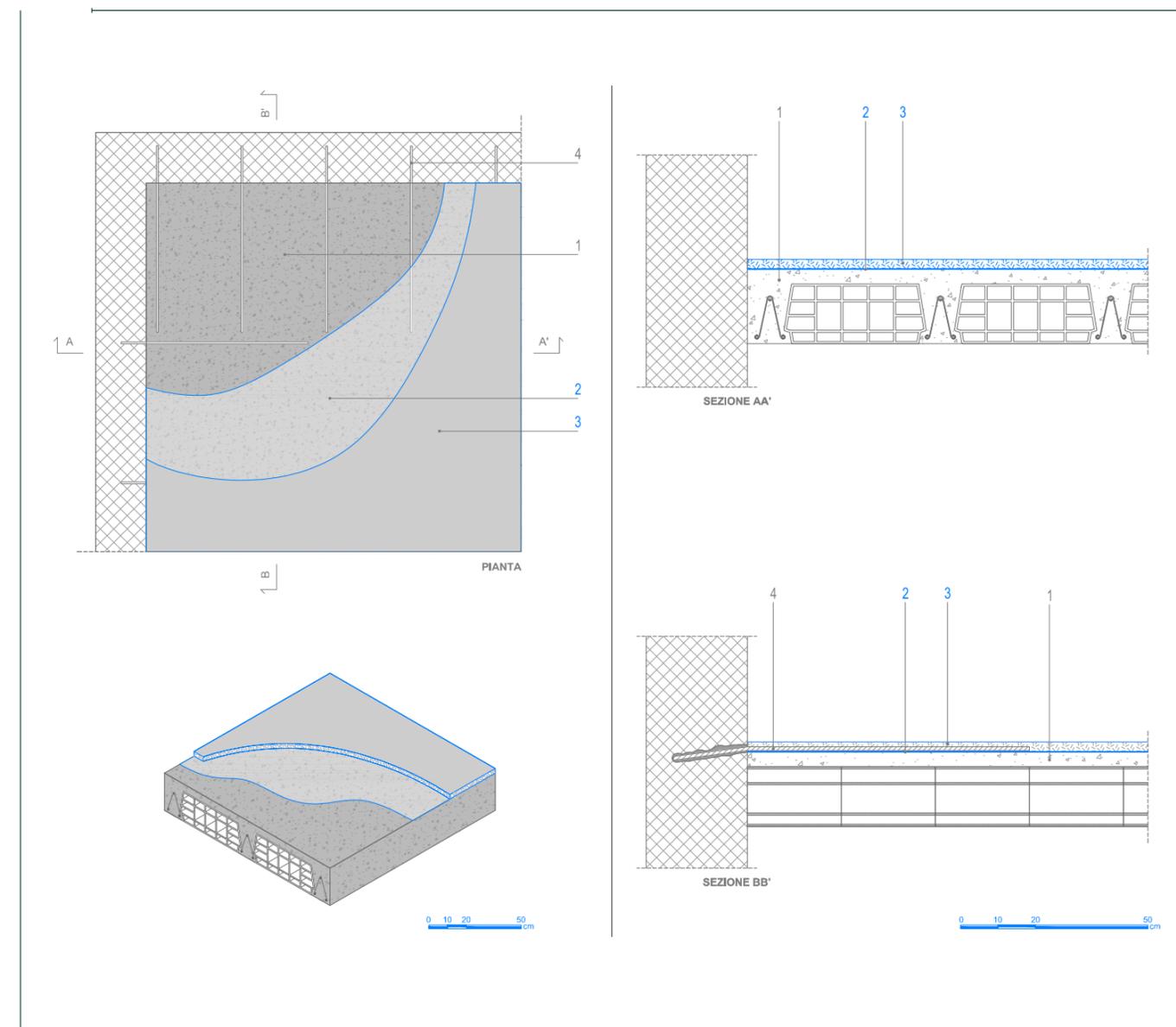
Il rinforzo estradossale di un solaio può essere eseguito mediante la realizzazione di una cappa collaborante in microcalcestruzzo **PLANITOP HPC FLOOR**. Eseguire la preparazione del supporto mediante lo svellimento di tutta la pavimentazione sino a raggiungere la cappa esistente e irruvidire quest'ultima mediante mezzi meccanici in modo da ottenere una superficie con scabrezza di almeno 5 mm che garantisca aderenza tra la cappa esistente e il **PLANITOP HPC FLOOR**.

→ Innestare dei monconi di collegamento in armatura tradizionale B450C alla muratura perimetrale o alle travi di bordo, orditi parallelamente ai travetti e ancorati all'interno di fori realizzati e puliti in precedenza, mediante fissaggio chimico epossidico **MAPEFIX EP 100** o fissaggio cimico a base di resina vinilestere **MAPEFIX VE SF**. Aspirare le superfici in modo da eliminare polveri e ogni materiale incoerente (foto A).

→ Consolidare estradossalmente la cappa esistente con **PRIMER 3296** diluito 1:1 con acqua (foto B).

→ Procedere, dopo almeno 4 ore dall'applicazione del primer, alla miscelazione in betoniera a bicchiere il **PLANITOP HPC FLOOR** (foto C).

→ Eseguire il getto di **PLANITOP HPC FLOOR** sul solaio in uno spessore di circa 2 cm<sup>(1)</sup> (foto D, E e F).



### NOTE

1. Attraverso il tool di calcolo **MAPEI STRUCTURAL DESIGN**, in conformità al CNR DT 204, è possibile definire lo spessore di **PLANITOP HPC FLOOR** necessario.
2. Nel caso in cui sia necessario eseguire una ripresa fra getti successivi di **PLANITOP HPC FLOOR**, sarà propedeutico l'impiego di **EPORIP** oppure il posizionamento di opportuni ferri di chiamata.
3. L'intervento di rinforzo con il **PLANITOP HPC FLOOR** non richiede né connettori né rete elettrosaldata.

**INQUADRA IL QR CODE** e scarica la scheda di rinforzo, le schede tecniche, i dwg, accedi ai software di calcolo e ad altre informazioni utili

oppure **SCARICA DAL SITO** [rinforzo-strutturale.it](http://rinforzo-strutturale.it)

